



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 玻璃芯基板: 新一代先进的封装技术

演讲人: 汤加苗 安捷利美维 FCBGA 总经理 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司

演讲摘要:

玻璃基 ABF 载板采用硅基玻璃作为芯板, 解决了有机基板翘曲的行业痛点问题。玻璃基 ABF 载板优势明显, 高温下的涨缩变形小, 可降低 50%的图形失真, 能提供紧密的层对层直接叠加互连所需的尺寸稳定性。玻璃基板的互连密度增加可多达 10 倍; 玻璃基板机械性能提高, 可实现超大尺寸、高组装产量的外形封装。玻璃基板在功率传输和信号路由的设计规则方面提供了更大的灵活性。能够与光学组件无缝互连集成, 并能在更高的温度流程下将电感器和电容器嵌入玻璃基板中, 有更好的功率传输解决方案。由于玻璃基板以上优点, 非常切合高密度高算力的 chiplet 应用场景, 可以满足 chiplet 高算力芯片的需求。安捷利美维公司作为国内封装载板领域龙头企业, 深入研究玻璃基 ABF 载板技术, 推动集群发展、链式发展和协同化发展, 为玻璃基 ABF 载板技术的发展和生态链建设做出贡献。

演讲大纲:

1. 厦门基地展示及产能介绍
2. TGV 玻璃基的优势以及工艺能力介绍
3. 下一代玻璃基板的发展趋势

适合对象:

1. 电子封装行业的专业人士, 包括封装工程师、技术研发人员等。
2. 半导体行业的相关从业者, 如芯片设计人员、制造工程师等。
3. 对高密度高算力芯片应用场景感兴趣的人士。
4. 关注玻璃基 ABF 载板技术发展的学者和研究人员。
5. 相关企业的管理人员和决策者, 以了解行业趋势和技术发展方向。

演讲人简介:

长期任职于跨国公司从事 ABF 高端载板研发、建厂以及大规模量产。深耕二十多年于电脑 CPU 芯片 ABF 载板, 服务器芯片 ABF 载板, EMIB ABF 载板, 玻璃基、陶瓷基 ABF 载板等大算力芯片相关的高密度载板。2001-2003 年在 IBM 日本载板厂工作(现日本京瓷野洲工厂); 2003 年 7 月加入英特尔, 从事高端 ABF 载板技术开发; 2009 年-2010 年在美国工作, 辅导国际头部 ABF 载板建厂到量产; 2018-2022 成为英特尔全球载板事业部技术与运营主要负责人(技术委员会负责人、创新委员会负责人、PCS 智能控制委员会负责人、全球封装材料变更控制委员会主席)。在近 6 年里, 主导建立两座为英特尔专供的 ABF 载板智能工厂, 并带领该公司从 ABF 载板从 0 到 1、从技术薄弱到全球行业领先位置的工厂。获得英特尔全球科技与制造成就奖。授权国际专利 18 篇及 20 多篇文章和 4 篇英特尔商业机密。